

SHOW
GUIDE

www.semipkgshow.com



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전
2023.8.30(수)-9.1(금), 수원컨벤션센터



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전

전시회 개요 EXHIBITION OVERVIEW

명칭	2023 Advanced Semiconductor Packaging Show 2023 (ASPS)
일시	2023.8.30()-9.1(), 3 / 10:00-17:00(16:30)
장소	
주최	
주관	
후원	

3.0

전시품목 EXHIBITION ITEM



PCB,



2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 혁신전략 컨퍼런스



“혁신적인 반도체 패키징 기술과 미래”

• : 8 30 () • : 3
 • : , • : T. 02-2168-9333 E. sekmaster@etnews.com

시 간	주 제	연사
12:30-13:10	Registration	
13:10-13:50	차세대 패키징 기술 로드맵과 Smart Factory 구상 1. 차세대 패키지 공정 기술 로드맵 및 도전 과제 2. DS부문 Back-End 제조혁신 및 Smart Fab	삼성전자 (이충선 팀장, 김희열 팀장)
13:50-14:20	EV 자동차용 파워모듈 패키징 접합기술 동향	한국전자기술연구원 (홍원식 수석연구원)
14:20-14:50	LAB(Laser Assisted Bonding) & 레이저를 이용한 차세대 Si반도체 본딩기술	프로텍 (고윤성 상무)
14:50-15:50	Break 및 [2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전] 개회식	
15:50-16:20	칩렛 집적을 위한 Laser-Assisted Bonding with Compression (LABC) 공정 기반 타일링 집적 공정 기술	ETRI (최광성 실장)
16:20-16:50	반도체 공정 및 패키징 소재 기술	홍익대학교 (이기영 교수)

2023 KAMP/소부장포럼 국제 심포지움



“미래의 선택 : 반도체 패키징 / 2차전지의 미래 그리고 비즈니스 찬스”

• : 8 31 () • : 3
 • : (KAMP), (SBJ)
 • : T. 031-6959-5843 E. kamp@kamp.or.kr

시 간	주 제	연사
10:00-10:10	개회사 및 인사말	한국마이크로전자패키징연구조합 (성학경 회장)
좌장 : 좌성훈(서울과학기술대학교 교수) / 반도체 패키징 기술 및 산업 동향		
10:00-10:40	Chiplet 첨단패키징 시대의 도래	한양대 패키징센터 (김학성 센터장)
10:40-11:10	차세대 패키징 기술에서의 필요소재기술	삼성전자 (김수연 상무)
11:10-11:40	반도체 패키징 기술 혁신을 이끌 신소재 "전자화물"	성균관대학교 (김성웅 교수)
좌장 : 정세영 (엔트리움 대표) / 2차전지 기술 및 산업 동향		
13:00-13:30	前PD가 이야기하는 2차전지의 기술 및 산업동향	한국전자기술연구원 (송준호 박사)
13:30-14:00	각형2차전지의 Cap Assembly 라인 제조공정 및 설비혁신	코닉에스티 (정무길 대표)
14:00-14:30	핵심산업(반도체/2차전지)의 공정혁신을 위한 소재기술	한국닛또덴코 (강성용 이사)
좌장 : 성학경 (한국마이크로패키징연구조합 회장) / 반도체 패키징 및 2차전지의 해외동향		
14:45-15:15	ASML/ASM의 나라, 네덜란드의 반도체/2차전지 기술 및 산업 동향	주한 네덜란드 대사관 (피터웰하우존 선임 과학기술혁신담당관)
15:15-16:00	일본을 뒷받침하는 일본 중소기업-벤처기업, 새로운 日韓시대에서의 상호연계	일본 TNP (Go Masatoshi 대표, 전 벤처협회장)
16:00-16:45	일본발! 일렉트로닉스전문전시회 'Nepcon Japan'의 확대와 Advanced Packaging의 기술발전	일본 RX Japan (Maezono Yuhi 집행의원)
16:45-17:00	폐회사	소부장기술융합포럼 (한형수 회장)

ASPS 2023 참가업체 기술세미나



• : 8 31 ()-9 1 () • : 1 103
 • : 가 • : T. 02-6285-9131 E. semipkgshow@jexpo.or.kr

장 소	일 시	시 간	주 제	연사
수원컨벤션센터 회의실 103호	8월 31일(목)	13:00-14:00	디지털트윈 솔루션을 통한 반도체 장비의 동적 기구부 검증 및 하네스 디자인 검증으로 개발.제조공정 단축실	델타아이티 (차규훈 부장)
		14:00-15:00	획기적인 해상도와 인공지능 기반의 X-ray 현미경을 통한 첨단 패키징 불량 분석	자이스코리아 (송봉석 부장)
		15:00-16:00	첨단 패키징 불량 분석 분야의 고효율 샘플 전처리 위한 Laser FIB 워크플로우	자이스코리아 (Dr. Vignesh Viswanathan)
	9월 1일(금)	13:00-14:00	성공적인 패키징 기술 개발을 위한 시뮬레이션 솔루션	태성에스엔이 (김지원 선임팀장/공학박사)
		14:00-15:00	반도체 및 전기차 배터리용 방열 소재, 전자파 차폐 소재 및 열폭주 방지 필름	엔트리움 (정세영 대표)

수원상공회의소 세미나 & 설명회



1) IP로 알아본 차세대 반도체 기술 동향

• : 8 30 () / 13:30-14:30 • : 1 102
 • :

2) 기술거래 설명회

• : 8 31 () / 14:00-15:00 • : 1
 • :
 • : T. 031-8000-9458 E. csm9773@korcham.net

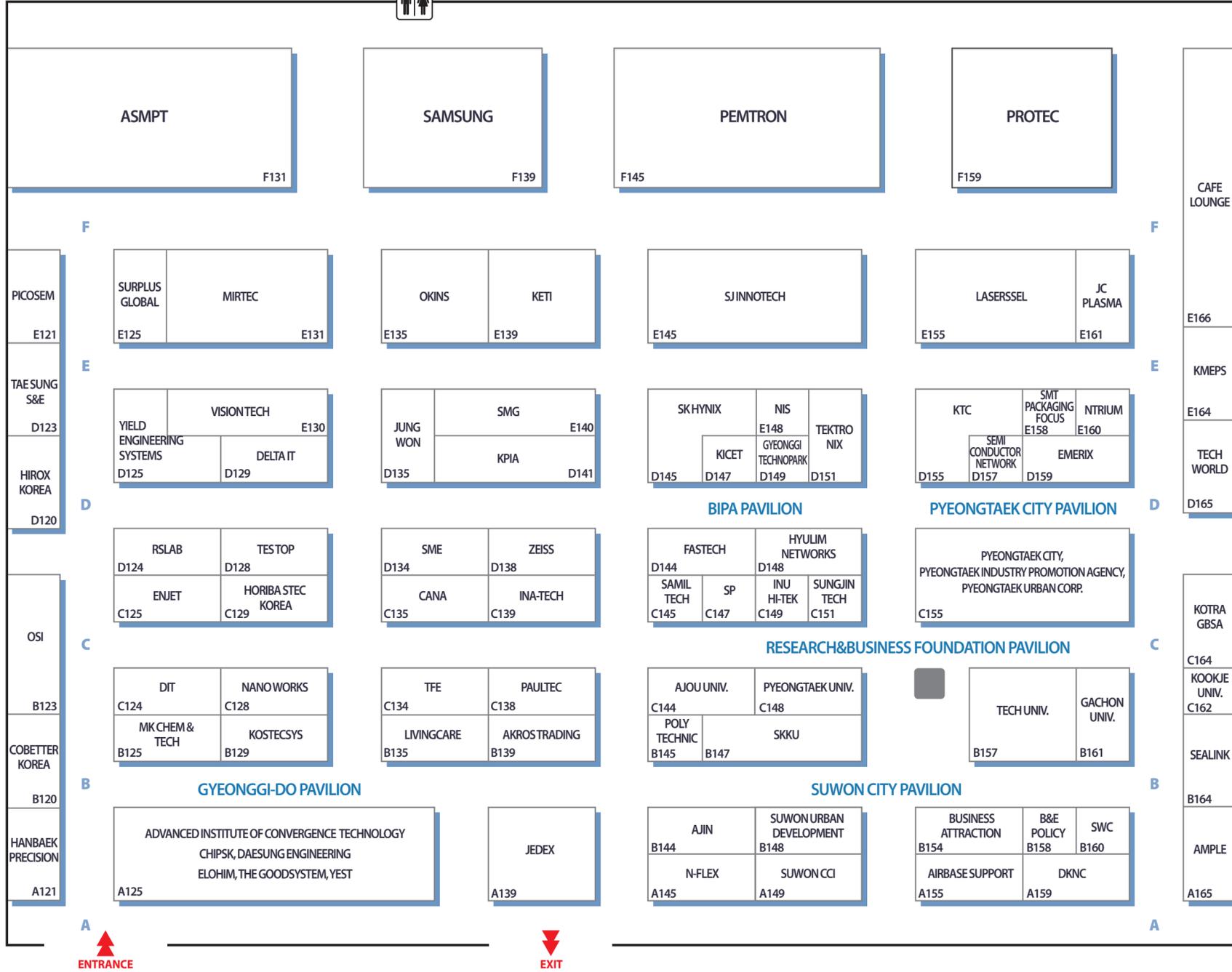
시스템 반도체 OSAT분야 전문 교육 세미나



1) 첨단 반도체 패키징 기술 및 동향

2) TSV 기술의 과거 현재 그리고 미래

• : 8 31 () / 14:00-16:00 • : 1 105-106
 • : T. 031-546-6531 E. csd@knc.re.kr



참가업체 리스트 EXHIBITOR LIST

가	B161 C164 D149 C162 C128 A145 A125 C164 A125 D129 C124 A159 C144 E155 B135 E131 D157 C145 E130 F139 C145 E125 B147 C151 B148 A149 A155 B154 B158 B164 C139	C144 B144 D124 D123 A125 A165 D159 B160 D134 E140 E145 E158 D145 C147 F131 C144 C125 E160 A145 B125 A125 B123 E135 B139 C149 D125 D138 A139 E161 D135 A125	E148 A125 C135 B129 D123 D128 D165 C134 D144 F145 C148 C155 C155 C155 F159 E121 D120 B157 D155 E164 D147 D141 E139 B120 D151 B145 A121 C129 D148 C128
---	--	--	--

EXHIBITOR LIST 가

EXHIBITOR	B/N
ADVANCED INSTITUTE OF CONVERGENCE TECHNOLOGY	A125
AJIN ELECTRONICS	B144
AJOU UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION	C144
AJOU UNIVERSITY NATTRC	C144
AKROSTRADING	B139
AMPLE	A165
ANSYS	D123
ASMP SMT SINGAPORE PTE	F131
BUCHEON INDUSTRY PROMOTION AGENCY	C145
CANA ELECTRIC	C135
CHIPSK	A125
COBETTER KOREA	B120
DAESUNG ENGINEERING	A125
DELTAIT	D129
DIGITAL IMAGING TECHNOLOGY	C124
DKNC	A159
ELOHIM	A125
EMERIX	D159
ENJET	C125
FASTECH	D144
GACHON UNIVERSITY	B161
GBSA	C164
GYEONGGI TECHNOPARK	D149
HANBAEK PRECISION	A121
HIROX KOREA	D120
HITACHI	C128
HORIBA STEC KOREA	C129
HYULIM NETWORKS	D148
INA-TECH	C139
INU HI-TEK	C149
JC PLASMA	E161
JEDEX	A139
JUNG WON CORP.	D135
KICET	D147
KOOKJE UNIV.	C162
KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE	E139
KOREA PACKAGING INTEGRATION ASSOCIATION	D141
KOREA TESTING CERTIFICATION INSTITUTE	D155
KOSTECYS	B129
KOTRA	C164
LASERSSEL	E155
LIVINGCARE	B135
MIRTEC	E131
MKCHEM&TECH	B125
NANOWORKS TECHNOLOGIES	C128
NEXT GENERATION INTELLIGENCE SEMICONDUCTOR FOUNDATION	E148
N-FLEX	A145

* ABC

EXHIBITOR	B/N
NORRES	A145
NTRIUM	E160
OKINS ELECTRONICS	E135
OSI MICROWAVE	B123
PAULTEC	C138
PEMTRON	F145
PICO SEMICONDUCTOR	E121
PROTEC	F159
PYEONGTAEK CITY	C155
PYEONGTAEK INDUSTRY PROMOTION AGENCY	C155
PYEONGTAEK UNIVERSITY	C148
PYEONGTAEK URBAN CORP.	C155
RAYR	C144
RSLAB	D124
SAMILTECH	C145
SAMSUNG ELECTRONICS	F139
SEALINK	B164
SEMICONDUCTOR CONVERGENCE CAMPUS OF KOREA POLYTECHNIC	B145
SEMICONDUCTOR NETWORK	D157
SG MEDIA	E158
SJ INNOTECH	E145
SK HYNIX	D145
SKKU RESEARCH&BUSINESS FOUNDATION	B147
SME TRADING	D134
SMG	E140
SP SEMICONDUCTOR & COMMUNICATION	C147
SUNGIINTECH	C151
SURPLUSGLOBAL	E125
SUWON AIRBASE SUPPORT DIV.	A155
SUWON BUSINESS & EMPLOYMENT POLICY DIV.	B158
SUWON BUSINESS ATTRACTION DIV.	B154
SUWON CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY	A149
SUWON URBAN DEVELOPMENT CORP.	B148
SWC	B160
TAE SUNG S&E	D123
TECH UNIVERSITY OF KOREA	B157
TECHWORLD	D165
TEKTRONIX KOREA	D151
TES TOP	D128
TFE	C134
THE GOODSYSTEM	A125
THE MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY	E164
VISIONTECH	E130
YEST	A125
YIELD ENGINEERING SYSTEMS KOREA	D125
ZEISS	D138

BOOTH NO. E131 **MIRTEC**

Since 2000
3D 비전 검사 전문 기업!!

MIRTEC의 디지털 3D기술이 글로벌 기준입니다!!

- ✓ 자유로운 디지털 패턴 변조로 고/저 부품 구분없이 높이 측정
- ✓ Blue Moiré 특허 보유로 정반사 / 광흡수 부품도 높이 측정

Stand : F131 **ASMP** enabling the digital world

SIPLACE CA2
High-speed chip assembly directly from the wafer and SMT placement in one machine

- Up to 75,000 cph for SMT components
- Up to 40,000 cph for flip chip from wafer
- Up to 50,000 cph for die attach chips from wafer
- Up to 10 μm @ 3σ for placement accuracy

BOOTH NO. E135 **Kins**

Reliability Test Socket, RF Connector, Coaxial Probe, Spring Probe

[주]오킨스전자

BOOTH NO. F159 **PROTEC**

프로텍은 1997년 설립된 반도체 패키징 관련 장비 제조 업체입니다. 프로텍은 설립 이후 끊임없는 연구와 개발에 힘써 현재 반도체 및 SMT분야의 고정도 디스펜싱 패키징 분야에서 세계적인 기업으로 성장하였습니다.

프로텍은 반도체 디스펜싱 분야에서 세계를 제패한 기술력과 자신감을 바탕으로 반도체 패키징 분야의 토털 솔루션을 제공할 수 있도록 끊임없는 연구와 개발을 하고 있으며 이를 통해 국가 산업발전에 기여하고 세계 최고의 반도체 장비 제조 기업이 되도록 최선을 다할 것입니다.

고객 여러분의 애정과 성원이 있기에 프로텍은 오늘도 도전을 현실로 만들어 가고 있습니다.